



最先端めっき実装研究会 2025年度第1回公開研究会

主催：最先端めっき実装研究会
協賛：電気鍍金研究会
協賛：表面技術協会

「難めっき材への挑戦！」

「ガラス/フッ素系樹脂/平滑基材へのめっきトレンド最前線」

最先端めっき実装研究会では、下記要綱で2025年度第1回公開研究会を開催いたします。今回は昨今各方面で盛んに研究開発が進められているガラス、フッ素系樹脂、平滑基材等、難めっき材へのめっきにフォーカスして、専門家の講師を招いて、ご講演頂きますので奮ってご参加ください。

開催日時 2025年7月15日(火) 13:00~17:05

開催方式 現地開催 & WEBハイブリッド(Zoom Webinarシステム利用)

開催場所： 回路会館地下1F会議室

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

13:00~13:05

開会挨拶 最先端めっき実装研究会 主査 奥野製薬工業株式会社 姜 俊行

13:05~13:50

講演「先端めっき技術を応用したガラスサブストレート」

大日本印刷(株) ファインパッケージング本部 フェロー 倉持 悟氏 【現地講演】

〈概要〉 独自の構造を持つガラスサブストレートを開発してきた。本講演では、先端めっき技術を応用した基板の技術的特徴と、次世代ハイパフォーマンスコンピューティング用アプリケーションを睨んだ、大型、高密度、高速伝送基板としての優位性を発表する。さらに、ガラス貫通電極をコアとした大型パッケージ用基板について、510×515mmサイズでの試作結果を報告する。

13:50~14:35

講演「ガラスコア・インターポーザに適しためっきプロセス及び関連技術」

アテックジャパン(株) エレクトロニクス事業部 事業部長 藤原俊弥氏 【現地講演】

〈概要〉 本講演では、近年注目を浴びているガラスコアやインターポーザ向けで使用が期待される、新しい湿式銅めっきプロセス(密着増強処理~前処理~化学銅処理~電解銅フィリング)を中心に、関連するめっきプロセスを紹介する

14:35~15:20

講演「TGV基板向け高密着表面処理プロセス」

奥野製薬工業(株)総合技術研究部 基板・半導体領域 領域長 吉川純二氏 【現地講演】

〈概要〉 大型化する半導体パッケージ基板のコア材に寸法安定性の高いガラスを使用する検討が盛んになっている。ただし、厚板ガラス材のスルーホール形成にスパッタシードでは限界があるため、オールウェットプロセスでの実現が求められている。本講演では、酸化亜鉛を密着層とした新しい湿式シード形成プロセスを中心に、スルーホールフィリングによる高信頼性表面処理プロセスを紹介する。

(休憩10分)

15:30～16:15

講演「銀シードを用いる平滑基材へのめっきと回路形成」

DIC(株)ケミロニクス事業本部ケミロニクス技術4Gサイエンティスト 深澤憲正氏【現地講演】

＜概要＞ 回路微細化や高速信号伝送の要請が高まっており、平滑表面上での配線形成技術が重要になっている。この課題に対し、基材表面を粗化することなく、高密着性を確保することが可能な銀シードめっき技術を提案する。配線層(銅)と異なる金属(銀)シードを用いるメリットについても紹介する。

16:15～17:00

講演「平滑界面で高密着銅めっきを実現するフッ素樹脂の表面改質技術」

大阪産業技術研究所 電子材料研究部 主任研究員 池田慎吾氏【現地講演】

＜概要＞ 伝送損失の低減に向けた回路基板製造の要素技術として、従来のアンカー効果とは異なり、化学的相互作用や結合に基づき平滑界面で高密着性を実現する接着／めっき前処理の重要性が増してきている。本講演では、フッ素樹脂のプラズマ表面改質に関する研究例を中心に接着界面の構造に迫る取り組みについて紹介する。

17:00～17:05

閉会挨拶 最先端めっき実装研究会

18:00～ 技術交流会(別途参加費必要)(先着25名)

会場周辺にて、講師を招いて技術交流会を行います。ご参加ください。

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

参加要項

定員 回路会館地下1F会議室: 50名 (先着申込順)
WEB (Zoom Webinar): 200名 (先着申込順)

参加費(消費税込み)

正会員: 5,000円、学生会員: 無料、研究会会員: 別払い、シニア会員: 2,000円
名誉会員: 無料、賛助会員の社員: 5,000円、賛助会員(クーポン利用): 無料
非会員一般: 10,000円、非会員学生: 無料、協賛団体(JPCA会員含む): 5,000円
技術交流会: 5,000円(消費税込み)

注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されますと、**返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。
- ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。
(お支払い方法: **クレジットカード決済またはコンビニ決済のみ**)(手数料学会負担)
- ③**領収書(宛名会社名選択可)**のご発行は、返信メールのマイページから**決済後に即日出力が可能**です。
- ④WEBの領収書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
- ⑤**賛助・特別クーポン**は、1枚/1口まで(複数口の場合は口数分)利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。※複数枚使用希望がある場合はお問い合わせください。

*キャンセルポリシー

お申込み後のキャンセルはできません。

下記から参加申し込みをお願いします。

会員

賛助会員

協賛会員

非会員

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会
E-mail: info@jiep.or.jp(メールアドレスは¥を@に置き換えてください)